

银行 IC 卡迁移已提及多年，随着各项条件的成熟，已到转折时机。2010 年人民银行发布新的《中国金融集成电路(IC)卡规范》，明确了推进的具体时间里程，拖延多年的银行 IC 卡迁移将成为现实，考虑到安全性问题和对 VISA 等国际巨头竞争问题，迁移趋势将不可能再回头。

替换市场巨大

从当前银行发卡类型来看，主要仍然为磁条卡，截至 2010 年第一季度全国累计的银行 IC 卡发卡量仅为 600 万张。但是从联网 POS 改造情况来看，截至 2010 年底即达全国 258.7 万台 POS 机，已经有 160 万台完成了受理金融 IC 卡的改造，按照人民银行的计划到 2010 年底将全部完成改造，银行 IC 卡迁移的受理环境改造已经完全具备条件。

目前银行年增发卡量约为 2.8 亿张，而截至今年一季度全国的银行发卡量为 21.69 亿张。在未来的 5 年内，预计将实现发卡的全面替换和原有存量卡的逐步替换。按照一般场景预测，将在未来 5 年实现年均新增 IC 发卡量 3-4 亿左右，对比 2009 年我国国内所有类型 IC 卡的发行量仅为 19.7 亿张，增长空间巨大。考虑到 IC 卡价格相对较高，银行 IC 卡的市场将从无到有，实现大幅提高。手机支付主要形式为 RF-SIM 方式、NFC 方式等等。之前推进手机支付力度最大的电信运营商中国移动[82.85 1.84%]采用的标准为 RF-SIM 方式，之后多种原因暂停了 2.4G RF-SIM 的推进。当前手机支付的方式三家运营商对 NFC 均较为青睐，其中中国移动有望在 TD 标准方面大力推进 NFC 标准。

从技术上来看，NFC 内嵌的芯片模块等同于 IC 卡的卡芯，同样包括控制、安全、存储等模块，NFC 标准的大力推行势必带来相应 IC 模块的大规模需求。而从价格上来看，NFC 的 IC 模块价格要高出普通银行 IC 卡几倍，其带来的市场空间不可小觑。我们认为，手机支付上的 IC 需求将成为未来金融 IC 产业的增量动力，推动金融 IC 产业的不断升级。若全部终端均内嵌 NFC 的 IC 模块，将大幅推动金融 IC 市场的增长。考虑到中国联通、中国电信均对 NFC 有试点，手机支付 NFC 标准推动下的金融 IC 需求将成为金融 IC 产业的又一片新天地。

产业链选股

国内的金融 IC 产业链已经初步成型，主要可以区分为芯片设计、封装、测试与软件系统、金融读写机具、加密算法等等。

芯片设计国内 IC 卡芯片主要还是依靠国外进口，国际厂商包括英飞凌、NXP 等等。

金融IC的推进必然涉及到金融安全问题，预计芯片设计的趋势将是逐步国产化。而相关的国内公司包括复旦微电子、大唐电信、同方股份、国民技术等等。

测试封装测试封装的产业主要都在国内，测试封装包括芯片封装成IC卡以及形成最终消费者使用的卡的形式，由于金融IC对安全的保密要求较高该领域的门槛也较高。国内企业主要包括东信和平、恒宝股份、长电科技、康强电子等等。

IC系统方案与软件由于IC卡本身即可视为一个小系统，因此IC卡都有内嵌的微系统，涉及该方面的国内企业主要包括恒宝股份、东信和平、握奇数据等等。

金融机具主要包括消费者受理终端POS机和ATM机，目前POS已经实现了大规模的改造，ATM的改造将主要是从ATM局部来进行，金融IC的推广使得支付更为便捷也将推动POS和ATM等的发展。国内相关的上市公司包括证通电子、信雅达、广电运通、信雅达等等。